



R-4積層品

CH2808F

リ波対応銅張積層板。途に訴求する。
無粗化箔を使用しながら高いピール(引き剥がし)強度を有している。誘電率が低く、ミリ波帯での伝送損失が極めて小さい製品。引き剥がし強度は1・2 kN/mと極めて高

い。伝送損失は0・05dB/mm(CP W伝送損失76g/ペル)と世界最高レベルの低伝送損失を実現。既に量産体制を構築済みで、粗度箔を用いて両面銅ミリ波レーダーや次世代高速通信規格(5G)アンテナ基板などの用

同社は、高速・大容量通信に適した低伝送損失のフッ素樹脂製品

中興化成工業は、つの提案強化に努めている。フッ素樹脂基板「チュー」「フロー銅張積層板 CH2808D」は、フッ素樹脂含侵ガラスクロスのミリ波レーダーや次世

代高速通信規格(5G)アンテナ基板などの用

ミドを複合したフレキシブル素樹脂とポリイミドフィルムのボリイミドフィルムに、誘電特性に優れるボリイミドフィルム

中興化成工業

中興化成工業は、つの提案強化に努めている。フッ素樹脂基板「チュー」「フロー銅張積層板 CH2808D」は、フッ素樹脂含侵ガラスクロスのミリ波レーダーや次世

代高速通信規格(5G)アンテナ基板などの用

ミドを複合したフレキシブル素樹脂とポリイミドフィルムに、誘電特性に優れるボリイミドフィルム

い。「XCCF-500」「XCP-500」を開発。同製品は、誘電特性に優れる充填材

は、非常にタフな材料

で耐熱性や耐薬品性に

優れる。260度まで

の高温から約180度

などの低温でも変質し

ない。電気絶縁性や誘

電特性、滑り特性、耐

候性などの特徴も併せ

持つ。一方で、加工が

非常に難しい材料でも

ある。

同社は1963年に設立され、創業以来長年、フッ素樹脂加工での課題解決に取り組んできた。高度な加工技術を強みに一品一様で、顧客の要望に合わせた加工を行

